原创看图快速学多层板叠层,阻抗计算, Si9000 的使用

在多层板设计中我们经常遇到 USB,HDMI, LVDS, DDR 及各种天线等信号要做阻抗控制,从而保证机器稳定及各项指标测试合格率。

那么我们在设计时是怎么控制阻抗的呢?

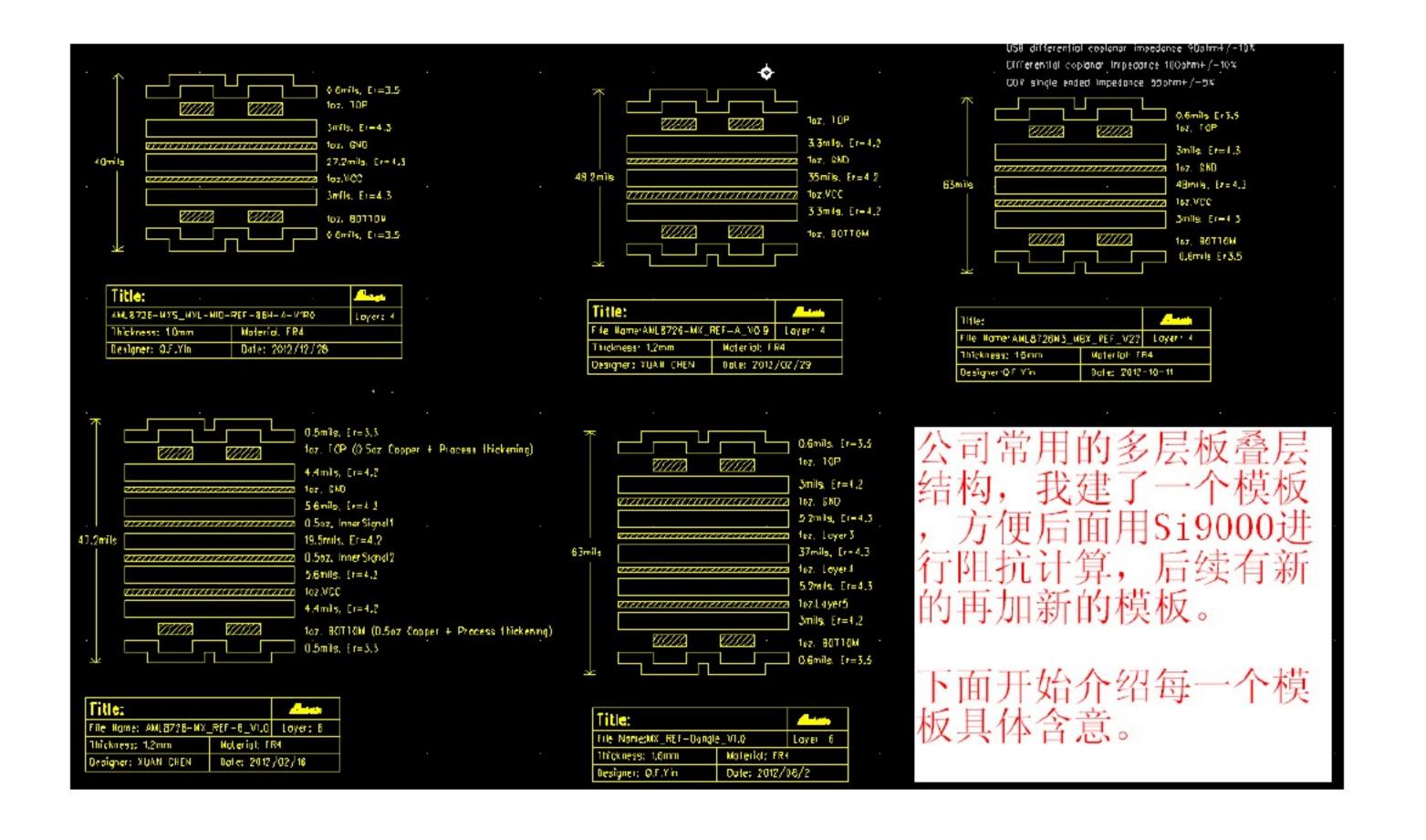
- 1.用经验值,把以前做过的阻抗线记录,例如,线宽线距板厚记录下来,下次用时直接套用。
- 2.先按常规设计,把 PCB 需要做阻抗的线高亮,然后截图给 PCB 板厂,要板厂控制,板厂会按我们要求的阻抗 对资料进行微调,比如调整线宽线距从而达到我们要求的阻抗。
- 3.在设计之初:我们按叠层参数,及要板厂提供相关资料(板材,介电常数,绿油,PP 片厚度等),再结合 Si9000 软件进行阻抗计算,算出来的参数走阻抗线;最后出洗板资料给 PCB 板厂的同时截图,要板厂进行控制阻抗,这样的好处是,一般情况板厂不会动我们的资料,要动也是很微小的调整。

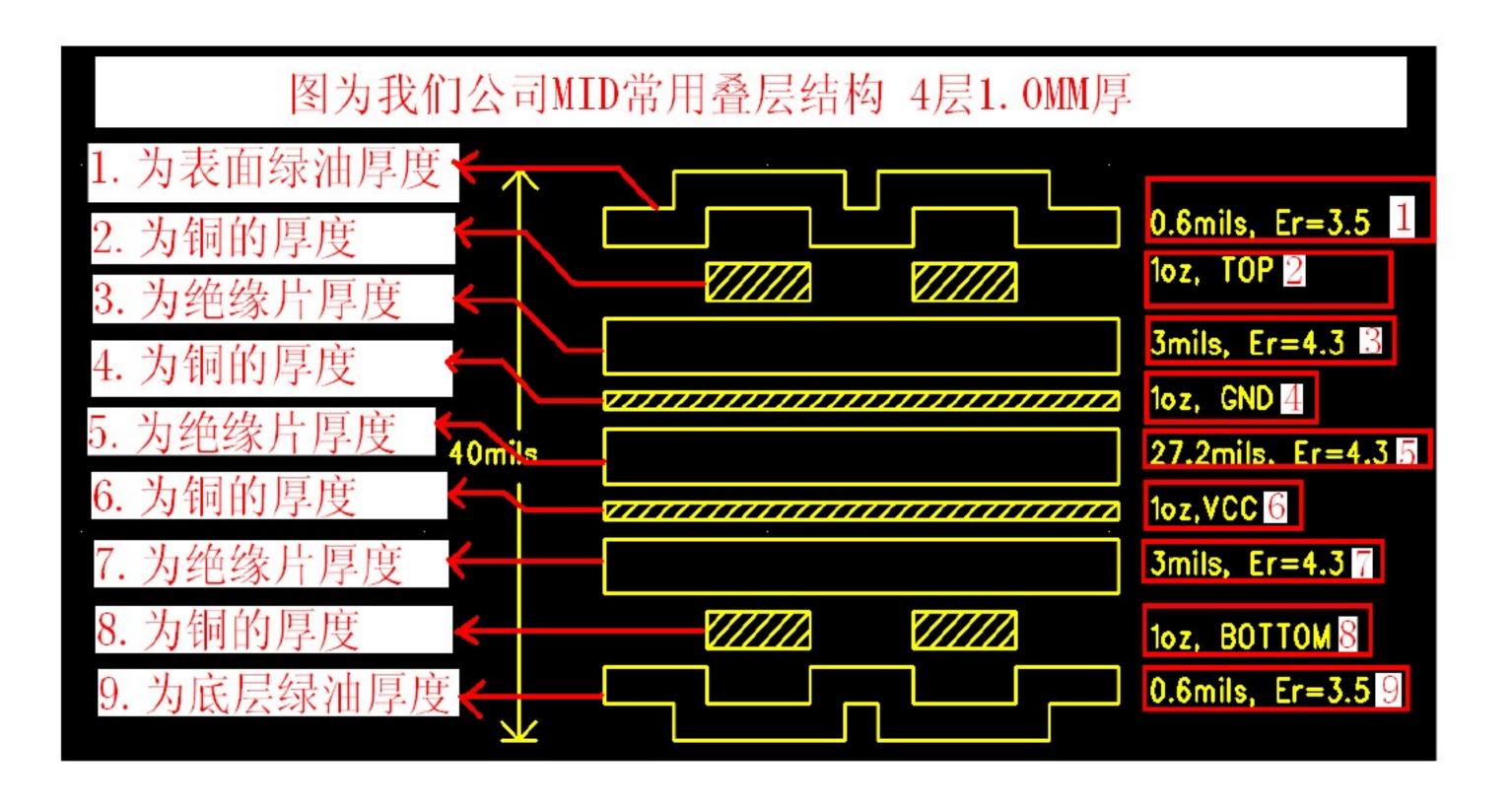
从上面可以看出,1与2点都不保险,第1点若 PCB 叠层参数变了,那么阻抗也会变,继续套用那天错了都不知道,第2.点截图要板厂控制,这个可是可以,但是也经常会遇到板厂工程人员打电话过来说,你的阻抗做不了,原因是你的设计的线宽线距相差太大,板上又没有足够的空间加宽线宽线距之类的。显然第3点方案最保险,不会出

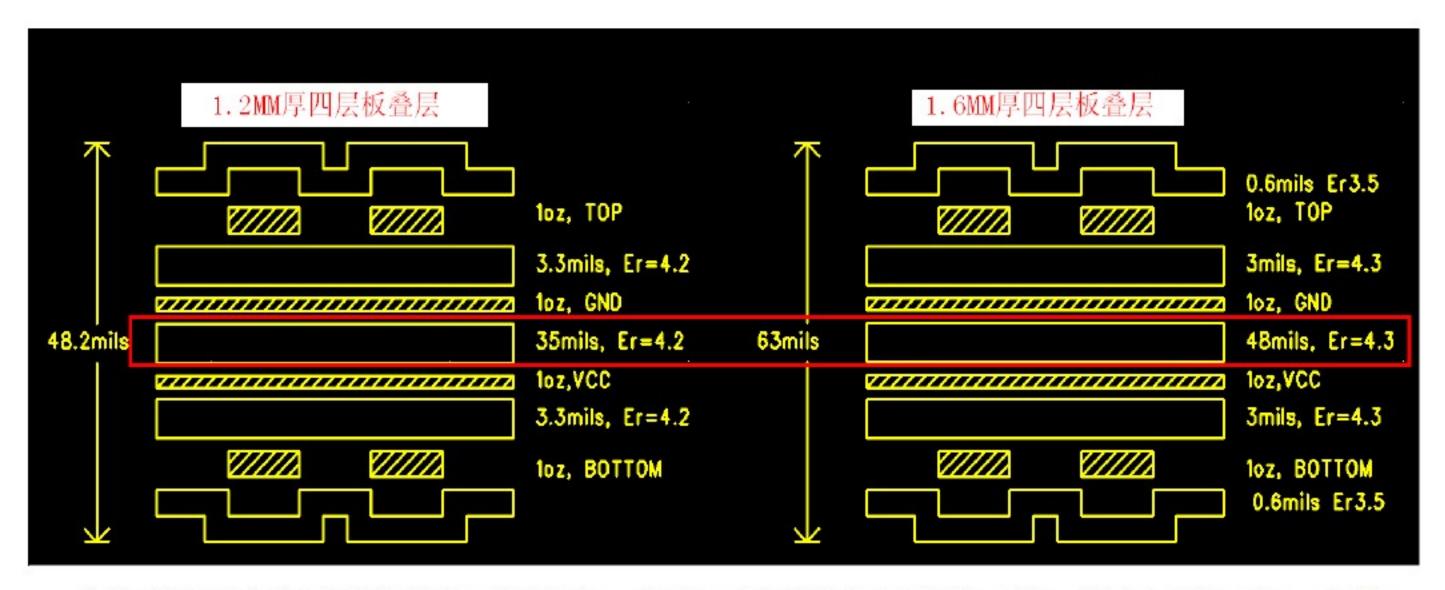
现板厂不能控制阻抗的现象发生。

好了, 现在我们开始学习 Si9000 的使用, 培训内容如下:

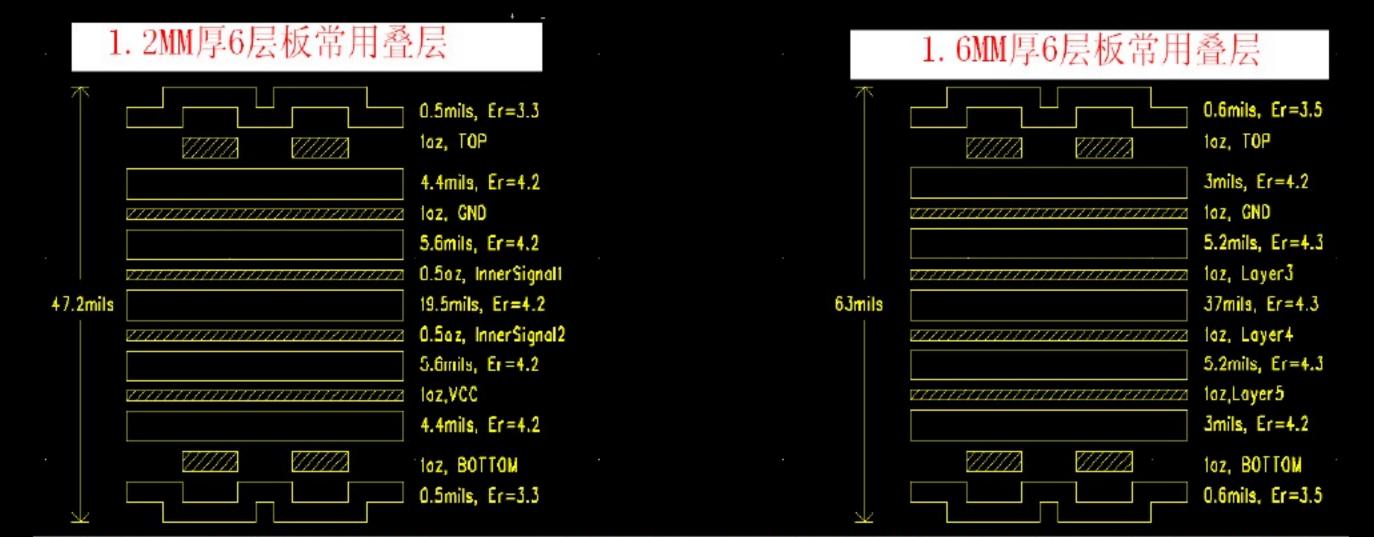
- 1.公司常用叠层模版说明
- 2.Shortcut to Si9000 阻抗计算软件界面讲解。
- 3.常用阻抗计算模版说明。
- 4.阻抗计算正推反推教程
- 5.实列一讲解(单端阻抗包地计算)
- 6.实例二讲解(差分对阻抗包地讲算)



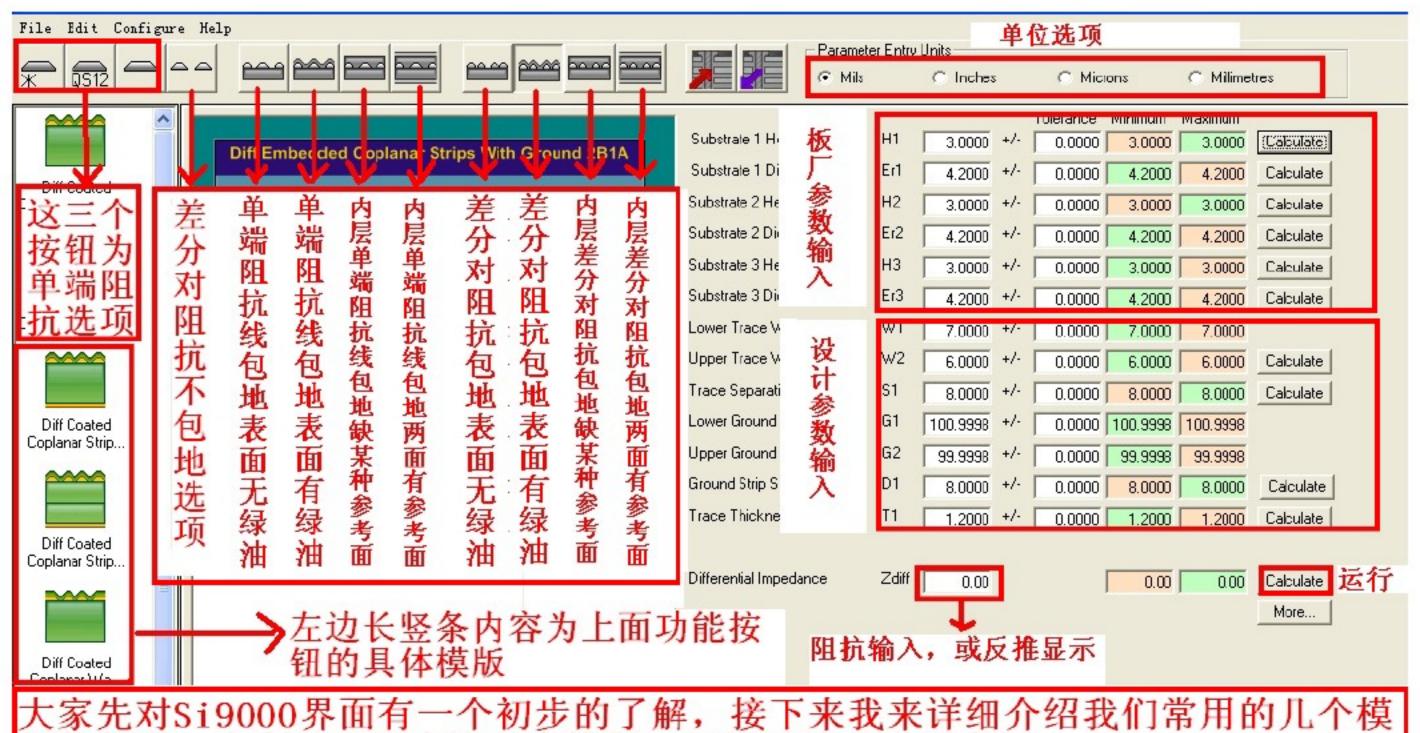




从这两个4层叠层截图我们可以看出,只有一层绝缘片厚度不一样,其它厚度一致,也就是说我们的四层板叠层不管是1.0/1.2/1.6MM厚,实际只改上图中红框这块PP绝缘片的厚度备注:1oz铜厚约等于1.3779Mi1s.



从这两个图中我们可以看出,顶层/底层的绿油及中间层/绝缘片的厚度有很多不相同,遇到这种情况我们可以这样做,1.在PCB设计后把我们需要的叠层模板加进去,出GERBER资料给板厂,PCB板厂看到会按我们叠层要求做 2.在设计之初向我们现有的PCB供应商要PCB板材,介电常数,绿油,绝缘片等相关参数,然后填写到新的模版中



大家先对Si9000界面有一个初步的了解,接下来我来详细介绍我们常用的几个模 版的使用,大家只要学会这几个模板,阻抗计算基本就会了。

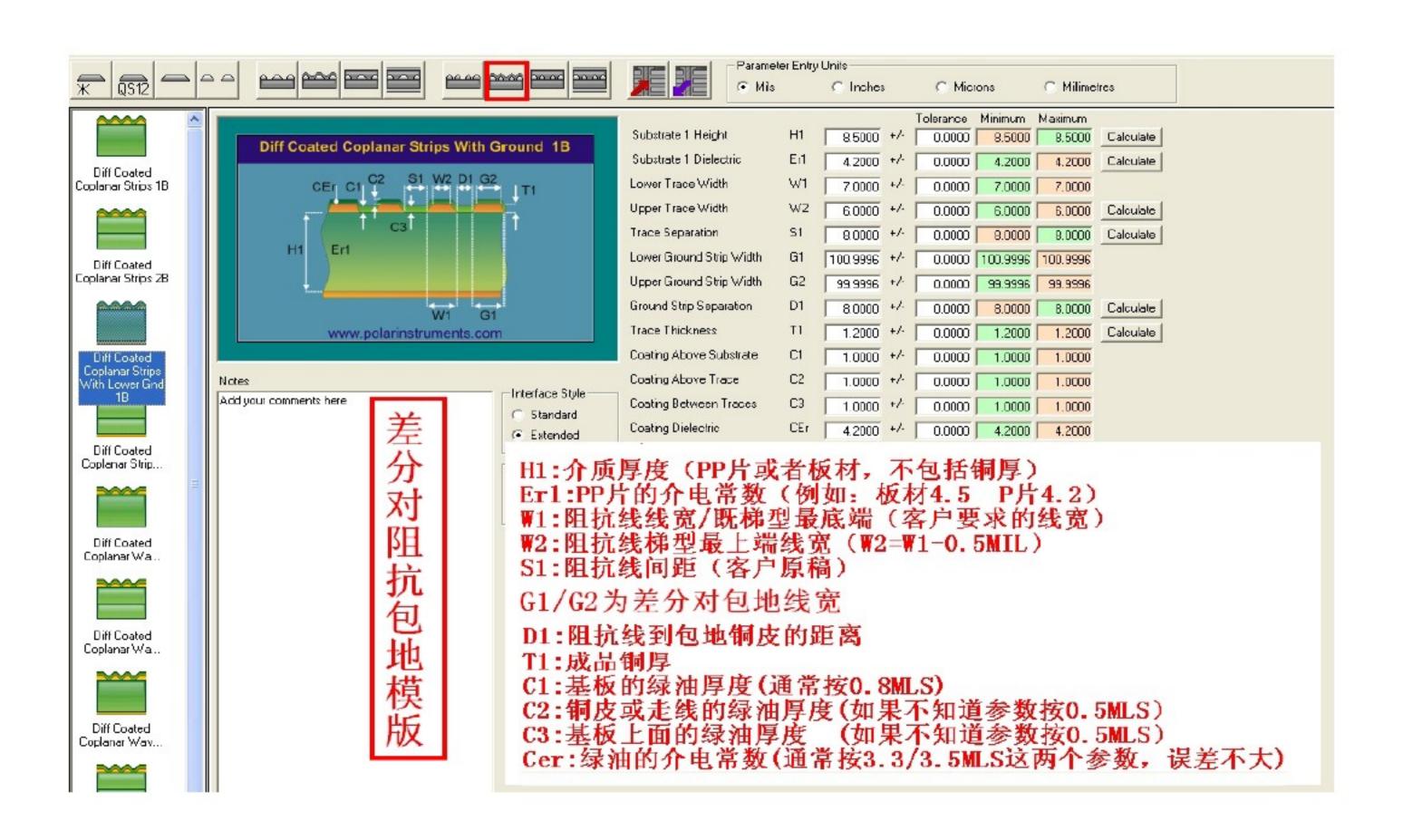


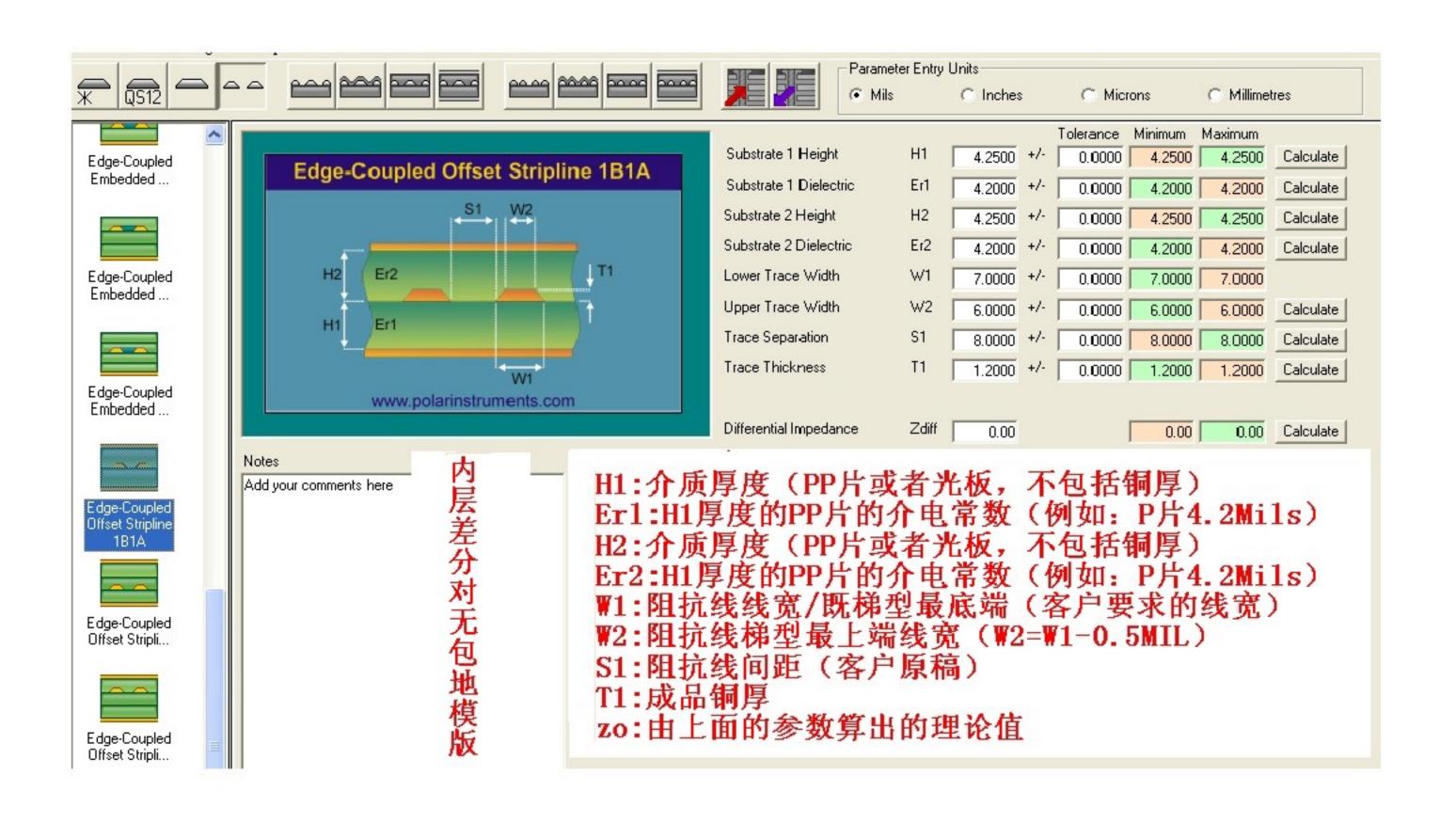








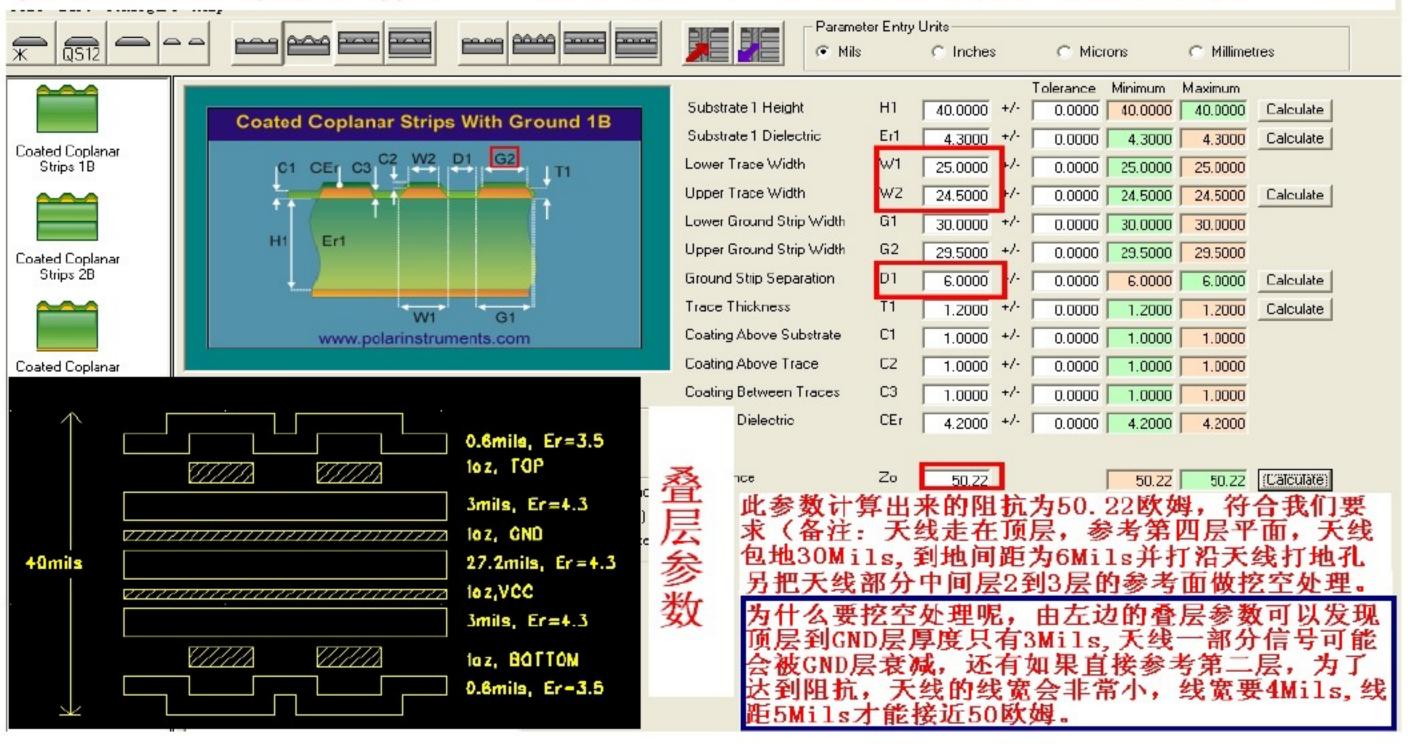








实列一:单端阻抗包地计算(MID 4层板上的WFIF天线,要求做50欧姆,误差百分之十)



实例二: 差分对包地阻抗计算(MID四层设计,要求对USB差分做90欧姆阻抗)

